



週間半導体ニュース

2026 年 8 月 10 日～ 8 月 16 日

ウォール街が AI 投資の資金を担い、TSMC の 7 月売上は 44.7% 増、メモリ不足は旗艦 GPU の構成にまで及んだ一週間。

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J

出典： NVIDIA ／ TSMC ／ Intel ／ ソニー ／ ホワイトハウス ／ EE Times ／ Tom's Hardware ほか

★ 今週の注目

5000 億ドル

NVIDIA が外部資本を動員

Apollo、BlackRock、Blackstone、ゴールドマン、KKR など 6 社と MOU を締結。AI インフラ向けに 5000 億ドル超の第三者資本を集める独立系の資金基盤を設ける（最終契約が前提）。

(NVIDIA、8/10)

294 億ドル

TSMC が投資枠を承認

取締役会が約 294.4 億ドルの設備投資枠を承認。先端技術・先端パッケージング能力の増強と工場建設が用途で、ソニーとのイメージセンサー合併も同時に決議した。

(TSMC 8/11)

192GB

メモリ不足が旗艦 GPU に

搭載量を 192GB まで削った Rubin Ultra 派生品を検証中と報じられた。同じ逼迫で RTX 5070 の店頭価格中央値は 36% 上昇している。

(Tom's Hardware 8/12)

1. AI チップ・GPU

① NVIDIA、Rubin Ultra の減量メモリ構成をテストか

The Information の報道によれば、搭載メモリを削減した Rubin Ultra を少なくとも 3 種検証中。発表済みの 16 スタックを下回る 192GB・256GB 版や、HBM4E から HBM4 への後退も含む。HBM4E のカスタム・ベースロジックダイが供給能力を圧迫している。

(Tom's Hardware／The Information、8/12)

② サムスンの HBM4 歩留まり 80%、SK は労務が火種

サムスンの HBM4 歩留まりが 2 月の量産開始時の 60% 未満から 80% へ改善したと報じられ、第 3 四半期に HBM4 売上を 3 倍以上に伸ばす計画。SK ハイニックスも 80% 台とされるが賃金交渉が 5 回目で決裂し、労務が増産リスクとなった。

(TrendForce、8/10)

③ インテルがメモリに再参入、XBM と ZAM を構想

タン CEO はメモリはもはやコモディティではないと述べた。DRAM セルを後工程に移し UCIe で転送する XBM と、ソフトバンク傘下 Saimemory と共同開発し HBM4 比約 2 倍の帯域密度を狙う 9 層積層 ZAM を挙げた。実現は 2029 ～ 30 年の想定だ。

(EE Times、8/14)

2. 製造とサプライチェーン

① TSMC の 7 月売上 44.7% 増、通年計画を上回るペース

7 月の連結売上高は 4675.8 億台湾ドルで前年同月比 44.7% 増、前月比 5.6% 増。1 ～ 7 月累計は 2 兆 8721 億台湾ドルで 37.0% 増となり、2026 年通年でドル建て 40% 強という会社計画を上回る勢いが続いている。

(TSMC、8/10)

② インテル、200 億ドルへ増額した株式発行を実施

1 株 95 ドルで 2 億 1053 万株を発行し、当初の 150 億ドルから 200 億ドルへ増額した。手取りは約 197 億ドル。用途は特定していないが、リスク開示では 14A、アリゾナの Fab52/62、オハイオ新工場が挙がる。需要は約 1000 億ドルと Bloomberg が報じた。

(Intel 8/10・Tom's Hardware 8/11)

③ アプライドが四半期最高、先端封止が逼迫点に

第 3 四半期売上高は過去最高の 91.15 億ドルで前年同期比 25% 増、前四半期比 15% 増。非 GAAP EPS は 3.50 ドルで 41% 増となった。TSMC も CoWoS/SoIC 能力を毎年ほぼ倍増させ、歩留まり 98% 超で需要と均衡に近づいたとしている。

(Applied Materials 8/13・DigiTimes 8/11)

③ 3. コンシューマー向け

① クアルコム、300ドル級ノート向け Snapdragon C

Kryo コアを最大 8 基積み、最高 3.0GHz、全コア持続は 2.0GHz。GPU は最大 900MHz、メモリは LPDDR5/5X/4X を最大 16GB。バッテリー駆動時に Intel N250 比でマルチ 67%、シングル 50% 高速と主張するが、AC 駆動時のベンチマークは示していない。

(Tom's Hardware、8/12)

② RTX 50 シリーズが最大 39% 値上がり

Blackwell の値上げが米小売に波及し、Newegg の RTX 5070 の中央値は 36%、RTX 5060 は 27% 上昇、RTX 5060 Ti 16GB は 39% 高となった。AMD 側はまだ追随しておらず、RDNA 4 の値上げは 1 桁 % にとどまると同記事は指摘している。

(Tom's Hardware、8/10)

③ インテル、次世代コアは Xeon より先にデスクトップ

ロバート・ハロック VP は次世代コアを Nova Lake としてデスクトップに先行投入すると述べた。EPYC Venice 先行の AMD とは逆の順序となる。デスクトップのロードマップは 2030 年まで描けているとするが、実機が手元にあるわけではないとも認めた。

(Tom's Hardware、8/16)

☰ 4. データセンターと電力

① NVIDIA と大手 6 社、5000 億ドル超の資本を動員

Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、ゴールドマン、KKR と MOU を結び、NVIDIA 製ハードを用いる AI インフラ向けに 5000 億ドル超の第三者資本を動員する独立系ファイナンス基盤を設立する。実行は最終契約の締結が前提となる。

(NVIDIA、8/10)

② Anthropic がマッコーリーと GIC と専用 DC 会社を設立

Anthropic を基幹テナントとする専用データセンターを開発・運営・賃貸する Theseus Infrastructure を設立した。保有と出資の大半はマッコーリー系ファンドと GIC が担う。Anthropic は自社拠点が招く消費者の電気料金上昇分を負担するとしている。

(Macquarie／Bloomberg、8/10)

③ PJM、データセンターの系統連系要件を見直しへ

7 月 22 日に北バージニアで発生した事故で約 4GW のデータセンター負荷が系統から脱落した。PJM 管内で過去最大の事象で、同機関は信頼性要件の強化を検討している。FERC は NERC に計算負荷向けの強制基準の策定を既に指示済みだ。

(Data Center Dynamics、8/13)

5. 自動運転と車載半導体

① Waymo、カリフォルニア 18 郡での有料無人運行を承認

州公益事業委員会が北部 12 郡・南部 6 郡での有料無人運行を承認し、サクラメントとサンディエゴが加わった。高速道路を含む全速度域と、雨・霧・雹での走行も対象となる（広範な降雪・凍結は除く）。年末までに週 100 万回の乗車を目標とする。

(Electrek、8/14)

② Uber と Pony.ai、欧州 4 都市に 2000 台を計画

両社は協業を拡大し、欧州 4 都市に Pony.ai のロボタクシー 2000 台を投入する計画を示した。最初の市場はクロアチアのザグレブとされる。残る都市名と具体的な時期はいずれも公表されていない。

(TechCrunch、8/14)

③ ティアフォー、レベル 4 向け AV チップを公開へ

JST 主導の次世代エッジ AI 半導体プログラムに参画し、レベル 4 自動運転向けのソフトウェア定義 SoC を開発する。完成後は論理設計とコンパイラ、ツールチェーンをオープンソース化する。TOSA 採用で更新をチップ再設計ではなくソフトで配信する。

(Automotive World、8/14)

6. スタートアップ投資

11 億ドル

River AI（AI 半導体・パロアルト）

General Catalyst と AMP PBC が主導し、シードとシリーズ A の 2 ラウンドで調達した。NVIDIA、AMD Ventures、Y コンビネーター、テマセクも参加。求人情報から ML 加速器を内蔵する独自 SoC の開発が示唆される。

(SiliconANGLE、8/11)

7.2 億ドル

リガク（X 線検査・東京）

Onto Innovation が少数株主として出資した。X 線回折・蛍光 X 線を用いた半導体のプロセス制御と非破壊検査が事業領域で、次世代の先端 X 線技術で協業を深める。

(FinSMEs、8/10)

1.36 億ドル

Point2 Technology（高速伝送・サンホゼ）

LB Investment 主導のシリーズ B 追加調達に Arm、NVIDIA、UMC Capital、Molex、Bosch Ventures らが参加し、累計調達額は 1.36 億ドル。独自の RF 信号方式で樹脂導波路上を伝送する Active RF Cable を手がける。

(FinSMEs、8/10)



7. 取引と政策

ソニー TSMC 熊本合弁

5月の予備的合意を法的拘束力のある最終契約に切り替え、熊本県合志市に合弁会社を設立する。ソニーが4650億円で支配株主となり、TSMCは2820億円を出資。量産開始は2029年を目標とする。

(ソニー、8/11)

韓国 5兆ウォン基金

素材・部品・装置とファブレス向けに5兆ウォン（35.2億ドル）の基金を新設し、貿易金融にも5兆ウォンを充てる。光州の飛行場を移転し830万平方メートルを産業団地候補地とする。

(ロイター、8/10)

BIS 規則の執行を要求

下院中国特別委のムーレナー委員長が、2025年に不執行とされたデュエリジェンス規則の効力確認をBISに求めた。ファウンドリやOSATが扱う14/16nm級のダイを規制対象と推定する規則だ。

(Tom's Hardware、8/11)

光モジュール輸入規制

FCCが中国製の新型光トランシーバーの輸入を禁じる案を準備。TrendForceの推計で中国勢は光モジュール能力の約56%を握り、米国のCoherentとLumentumは約30%の受注超過にある。

(Tom's Hardware、8/11)

8. 関税と州政策

232 条：ドローンと部品に最大 100% の関税

25kg 超の機体、熱画像搭載機、ドッキングステーションと一部重要部品に 100%、小型機やその他部品に 25% を課す新布告に署名した。日本、EU、韓国、台湾、スイス、リヒテンシュタインは 15%、英国は 10% の同盟国上限が原産地条件付きで適用される。発効は署名から 21 日後の 2026 年 9 月 3 日で、非重要部品は 180 日後まで猶予される。輸入電子部品や熱画像装置に直接課税する点で、今週最も半導体に近い関税措置となった。

(ホワイトハウス、8/13)

カリフォルニア州：初のティーン・テック協議会

ニューサム知事のカリフォルニア・イノベーション協議会と NPO #HalfTheStory が、10 学区超から集まった 10 代 20 人をスクラメントに招き初会合を開いた。AI の安全性、ディープフェイク、教室での生成 AI、AI リテラシー、人とのつながりの維持を議題とした。州全域の募集は今秋に始まり、研修は 2027 年春の予定。新たな行政命令や立法、予算措置の発表はない。

(ニューサム知事室、8/11)



出典

- Bloomberg
- Reuters (via ThePrint, BNN)
- CNBC
- WSJ (via syndication)
- TechCrunch
- The Information (via T'sH)
- Nikkei Asia
- EE Times
- Tom's Hardware
- DigiTimes
- TrendForce
- Data Center Dynamics
- SiliconANGLE / Crunchbase
- FinSMEs
- Blocks & Files
- Electrek
- Automotive World
- TSMC / Taipei Times
- NVIDIA Newsroom
- Intel Newsroom
- Applied Materials
- Cerebras Systems
- Sony Semiconductor
- Macquarie Group
- The White House
- Federal Register / BIS
- Gov. Newsom's Office
- Tier IV

本ダイジェストは2026年8月10日～16日に公表された記事のみを対象とし、各項目の引用表記は出典記事へのリンクになっています。

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J